长电科技2021年半年度业绩说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日（星期二）10:00-11:00通过上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）以视频播放结合网络文字互动的方式召开了2021年半年度业绩说明会，公司首席执行长（CEO）郑力先生、首席财务长周涛女士、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1、三季度营收多少

回复：您好，公司目前订单饱满，经营稳定，随着三季度部分客户进入需求旺季。公司有信心在今年下半年继续保持增长势头。谢谢！

2、请问郑总，您怎么看这一轮的半导体景气周期？虽然目前还处于较高多的景气度，但下游需求似乎已有分化的迹像，不知道您认为未来1-2年的景气度会是怎么样的？主要的增长驱动因素会来自于哪里？

回复：全球半导体一两年得益于芯片应用的领域的扩大，汽车电子化和新动能，仍将处于较快的增长周期。受益于5G通讯网络、人工智能、汽车电子、超大规模数据中心等应用端需求的增长。从长远来看，对消费电子和芯片驱动设备不断增长的需求将推动半导体市场在未来几年继续保持增长。

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能的发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出入脚数大幅增加，使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术，以及系统封装(SiP)等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一，半导体封测行业也在由传统封测向先进封测技术过渡，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升。根据 Yole的数据，先进封装全球市场规模将会从2018年约276亿美元增长至2024年约436亿美元，在全球封装市场的占比也从42.1%左右提升至49.7%左右，2018-2024年全球先进封装市场的CAGR 约8%，相比同期整体封装市场（CAGR=5%）和传统封装市场，先进封装市场的增长更为显著，将为全球封测市场贡献主要增量。

3、关于下半年有传言半导体封测行业会保持部分产品进行涨价以应对全球通胀处理？关于这个传言您保持什么看法？

回复：您好，公司会结合产能分配情况、原材料价格变化，对部分产品结构和价格进行调整。谢谢！

4、请问目前订单已经接到下半年了吗？

回复：您好，公司目前订单稳定，产能利用饱满。谢谢！

5、公司目前有买回库藏股的计划打算吗？

回复：您好，公司高度重视公司在资本市场的动态与投资者意见，公司将根据市场变化与公司实际情况，研究和考虑您提出的相关措施，并将投资者的合理意见和建议反馈给公司的董事会与大股东。同时公司也将通过良好的业绩和持续的股东分红，为投资者创造长期的投资回报，谢谢！

6、据说，好几个厂区因限电而停产，情况属实吗

回复：您好，公司目前并未因上述政策受到停产或减产的影响，国内各工厂生产经营保持正常。若相关政策对公司生产经营产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

7、感谢贵公司全体成员的辛勤劳动，目前市场担心的主要是巨额解禁和国家大基金的减持，请问在和资本市场的沟通方面特别是国家大基金暂缓减持，您有什么计划和安排吗？

回复：您好，公司高度重视公司在资本市场的动态与投资者意见，公司将根据市场变化与公司实际情况，研究和考虑您提出的相关措施，并将投资者的合理意见和建议反馈给公司的董事会与大股东。同时公司也将通过良好的业绩和持续的股东分红，为投资者创造长期的投资回报，谢谢！

8、公司目前的产能扩张是什么计划？产能扩张中先进封装的占比多少？

回复：您好，公司正按照之前公告的43亿元人民币固定资产投资计划根据实际客户需求与公司投资节奏稳步进行扩产。下半年继续有扩产产能陆续开出。因目前客户强劲的需求，公司还将小幅追加资本开支。公司先进封装的收入占公司收入的一半以上，同时公司今年的固定资产投资中的三分之二是用于先进封装技术相关的产能扩充，将持续扩大先进封装的收入比例。谢谢！

9、关乎制造成本一块是否会受到大宗商品及全球原料成本影响？影响有多大？还有关于韩国税收优惠政策是否落地了？

回复：您好，原材料价格变动确实对公司产品成本有一定的影响，但是公司已采取多种措施包括但不限于加强成本控制，集团化采购等应对这一情况，同时我们积极的与供应商沟通，保证原材料的供给，另外对于原材料价格变化，对部分产品价格进行了调整。根据公司半年报情况看，公司毛利率保持同比上升，盈利能力持续改善。我们正与韩国政府积极接洽，争取取得最大的税收优惠。谢谢！

10、公司如此好的业绩，没有反应在股价上。近期股价反复走低，公司有什么措施吗？

回复：您好，除基本面以外，公司股价波动同时也受市场情绪热点、基金投资偏好等多方面因素影响。从年初至今虽半导体制造及封测行业景气度居高不下，产能紧张现象仍在持续，各相关公司也纷纷发布了业绩较去年同期大幅增长的中期业绩。但制造与封测板块股价表现落后于整体半导体板块例如设备材料与设计板块。公司管理层自始至终致力于加强公司治理、优化公司运营、积极发展公司业务，持续为股东创造价值，并努力提高市场对公司内在价值的发现和认可。公司也持续加大和资本市场的沟通力度，积极安排了多场与海内外投资者的电话交流与现场调研，通过多种宣传渠道积极的向投资者传导公司中报的优秀业绩及基本面向好的预期，给与投资者正确的业绩引导。自从业绩发布后，二十多家券商分析师对公司的中报业绩给予了十分积极的评价。管理层有信心继续保持基本面的向上势头，通过良好的业绩和持续的股东分红，为投资者创造长期的投资回报。谢谢！

11、（1）公司目前产能利用率饱满，下半年产能投产计划如何？相继达产后产能利用率会下降吗？（2）目前公司在手订单及预计订单情况（3）公司有没有受到能耗双控影响？

回复：您好，公司目前订单稳定，随着下半年公司客户进入旺季和新产能的爬坡，预计业绩会保持稳健成长。同时，公司多元化的客户结构可以使我们很好的抵抗部分行业需求的波动。

下半年公司继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用，以及与之对应的国际和国内的重点客户订单强劲需求。同时，国内外各工厂持续加大运营管理能力的提升，积极调整技术和产品结构，进而持续推动盈利能力提升，同时也做好各方面的风险管控和预案准备，力争今年营收增长率高于全球行业平均增长率。公司目前尚未因上述政策受到停产或减产的影响，国内各工厂生产经营保持正常。若相关政策对公司生产经营产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

12、请问贵司封装芯片在国内外的市场占有率有多少，前景如何，国内的主要竞争对手有哪些。贵公司上半年净利润已超去年全年，下半年产能有望全部释放么，谢谢

回复：您好，根据台湾集邦咨询公司最新的2021年2季度数据，公司约占全球封测市场份额为14%。公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，在全球范围内战略布局六大生产基地和两大研发中心，面向全球客户可以提供方位的芯片成品制造一站式服务；同时公司具有国内外丰富的顶尖客户群体及全球多元化客户资源；公司的管理层具备国际化管理经验，在过去两年帮助公司实现了海内外协同发展。从技术角度，公司已经布局先进封装多年，掌握包括系统级SIP技术，高密度扇出型晶圆级技术，倒装技术，2.5D/3D等并已实现了大规模的生产，拥有3200多项专利，在全球封测厂商专利数量排名第2。对于国内竞争对手我们有绝对的领先优势，对于国外前两名同业公司相比我们虽然存在收入规模差异，但是我们在利润率方面已经迎头赶上，相信在不远的将来，通过自生及外延增长等多种方式公司能在目前的位置上进一步提高市场份额，缩小差距。下半年扩产产能陆续按计划开出，预期会迅速填满，来满足国际和国内客户强劲的订单需求。谢谢！

13、郑总，您好！请介绍一下长电科技完成对ADI新加坡测试工厂收购，对公司下半年的产能增加多少？预计营收增加多少?谢谢!

回复：尊敬的投资者您好。公司于2021年6月1日完成对ADI 新加坡测试厂房的收购，公司在新加坡的测试产能增加了约七十多台测试设备，此举有利于新加坡工厂的产品结构调整与全球化经营布局快速稳步前行。谢谢！

14、感谢公司管理层的努力和贡献。请问公司最新的扇出型2微米技术何时投产？产能如何？订单如何？应用前景如何？谢谢

回复：您好，公司近日宣布正式推出XDFOI™全系列极高密度扇出型封装解决方案，能够有效提高芯片内IO密度和算力密度的异构集成被视为先进封测技术发展的新机遇。该封装解决方案是新型无硅通孔晶圆级极高密度封装技术，相较于2.5D 硅通孔（TSV）封装技术，具备更高性能、更高可靠性以及更低成本等特性。该解决方案在线宽或线距可达到2um的同时，可实现多层布线层，另外，采用了极窄节距凸块互联技术，封装尺寸大，可集成多颗芯片、高带宽内存和无源器件。目前已完成超高密度布线，即将开始客户样品流程，预计明年下半年量产。重点应用领域为：高性能运算应用如FPGA、CPU/GPU、AI、5G、自动驾驶、智能医疗等。欢迎大家关注长电科技微信公众号，以便更加及时了解各项应用技术的发展。谢谢！